

非破壞性之電顯樣品技術

本院覽號

02T-1030730

公告日期

智財權狀態

know-how

摘要

利用特殊製作之制具，直接將非傳統前處理之樣品送入電子顯微鏡中，以穿透電子顯微術，搭配高角度等分析技術，可用來觀測及分析平常無法觀測之非傳統穿透電子顯微樣品，例如晶片薄膜或原子力顯微鏡用之針尖分析等等。

技術優勢

一般穿透式電子顯微鏡樣品之製作，需先將樣品切小磨薄，前處理成很小的樣品，才能觀測。本技術無需將樣品破壞，甚至可讓樣品在觀測後繼續使用。

應用範圍

奈米等級之非破壞性材料結構性分析。

創作人

薛韻馨、陳怡蕙



中央研究院
ACADEMIA SINICA